

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

100-780

AU 2503 40263

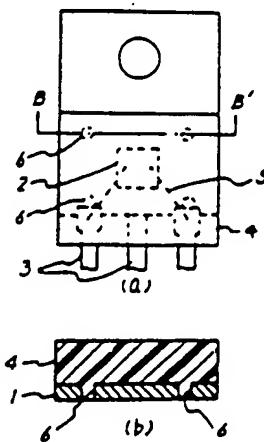
JP 357045959 A
MAR 1952

64

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE
(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP
(21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980
(71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI
(51) Int. Cl. H01L23/28

PURPOSE: To improve the adherence of a resin sealed semiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions sufficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.



1/11/16

⑨ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-45959

⑪ Int. Cl.³
H 01 L 23/28

識別記号

厅内整理番号
7738-5F

⑫ 公開 昭和57年(1982)3月16日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑬ 樹脂封止型半導体装置

⑭ 特 願 昭55-121513

⑮ 出 願 昭55(1980)9月2日

⑯ 発明者 明石進一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑰ 出願人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑱ 代理人 弁理士 内原晋

明細書

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

放熱板とこの放熱板に固定された半導体素子とこの半導体素子を包覆する封止樹脂とを備えた樹脂封止型半導体装置について、前記放熱板には前記半導体素子の固定部から離れた位置に穴があけられ、この穴部分までも前記封止樹脂が張り詰めたりかつ穴内に充填されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は樹脂封止型半導体装置、特に放熱板が樹脂の外に出し大面積封止型半導体装置に関するものである。

一般に樹脂封止型半導体装置については、外部環境の影響を受けやすく、気密封止構造を用いた

半導体装置に比べ信頼性が劣るという欠点がある。特に耐圧性に対しては、一般に金属からなる放熱板と封止樹脂との密着性が充分でない為に、その境界面からの水の侵入を完全に防止することは難しい。放熱板と封止樹脂との密着性を上げる為に、従来は、(1)放熱板側面に突起をつける。(2)放熱板の樹脂封止される部分にV型溝等の溝を入れる。(3)封止樹脂として金属と密着性の良好なものを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも充分な効果は得られていない。

すなわち、第1圖(a), (b)に従来の樹脂封止型半導体装置の一片の平面図とそのA-A'断面図を示す。図において、矩形の金属製放熱板1の片面の一方に片寄った部分に半導体素子2が固定され、この固定部について、半導体素子2はその引出しリード3と共に封止樹脂4により包囲されて外部環境から保護されている。5は素子と引出しリードを接続するシンディングワイヤである。

しかしながら、このような従来の半導体装置では、封止樹脂4と放熱板1とは早に接触している

だけで、いかなる、或いつき、がなれども、特に高湿では樹脂と放熱板との間の密着性の低下により密着性が低下してしまうという欠点があった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、放熱板と封止樹脂との間の密着性をよくし、よって、水分の侵入することなどが防止されて信頼性の向上された樹脂封止型半導体装置を提供することにある。

本発明の樹脂封止型半導体装置は、放熱板とこの放熱板に固定された半導体素子とこの半導体素子を包覆する封止樹脂とを備え、さらに前記放熱板には前記半導体素子の固定部から離れた位置に穴があくられ、前記封止樹脂はこの穴部分まで張り被さりかつ穴内に充填されている構成を有する。

つぎに本発明を実施例により説明する。

第1図(a), (b)は本発明の一実施例の平面図およびそのB-B'断面図である。

第2図(a), (b)は本発明の一実施例の平面図およびそのB-B'断面図である。第1図(a), (b)に示す従来例と比べて、放熱板1には、半導体素子2の固定部から十分離れた位置のA-A'直線に穴

11月25日- 45959(2)

6が設けられ、この穴の部分までも封止樹脂4により張り被さっているが、さらに穴6の中にも充填されている。

このように穴6を設け、この穴の中にも封止樹脂4が張り込まれていることにより、放熱板1と封止樹脂4との間に、いかなる、或いつき、ができない、高湿においても密着性の低下はなく、水分の侵入などが十分防止される。

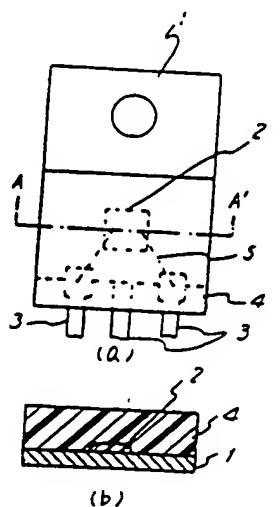
4. 図面の簡単な説明

第1図(a), (b)は従来の樹脂封止型半導体装置の一例の平面図および断面図、第2図(a), (b)は本発明の一実施例の平面図および断面図である。

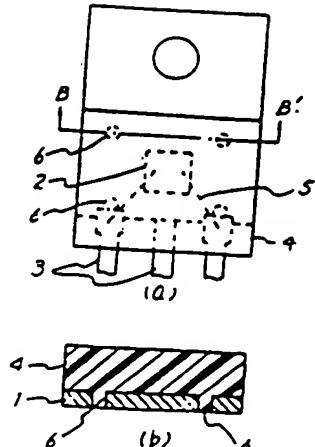
1……放熱板、2……半導体素子、3……引出
シリード、4……封止樹脂、5……マンディング
ワイヤ、6……穴。

代理人 井端士 内 廉

新規
実用



第1図



第2図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 55-163868
 (43)Date of publication of application : 20.12.1980

(51)Int.Cl.

H01L 23/48

(21)Application number : 54-071117
 (22)Date of filing : 08.06.1979

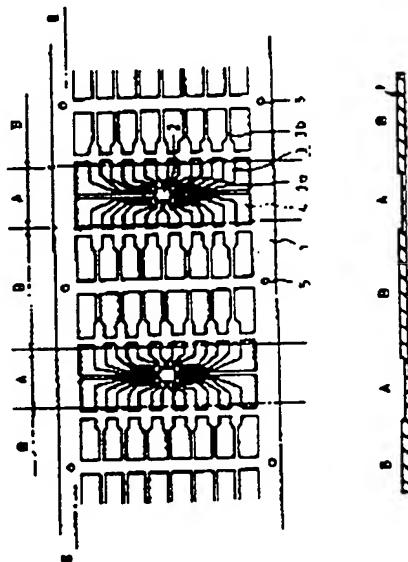
(71)Applicant : FUJITSU LTD
 (72)Inventor : AOKI TSUYOSHI
 KUBOTA AKIHIRO
 YAMAUCHI OSAMU
 SUGIURA RIKIO

(54) LEAD FRAME AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the strength of an external connector in a lead frame of a resin molded semiconductor device and increase the density of a chip connector by forming thin chip carrying base of the lead frame and thin lead terminal formed therearound and thick external connecting lead terminal.

CONSTITUTION: A guide hole 5 is perforated at a metallic plate, and thin and thick portions A and B are formed by pressing. Then, a chip carrying base 2 and a lead terminal 3 are formed on the lead frame 1 by stamping. The semiconductor chip is carried on a chip carrying base 2, wire bonded to the lead terminal 3, and clamped from both front and rear surfaces of the molding frame, resin is filled to seal the semiconductor device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2000 Japan Patent Office